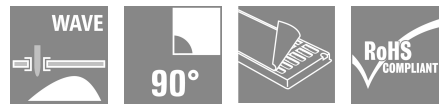


## USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



産業用デバイスの信頼性の高い USB データインターフェイス。多くの利点から、電気業界では USB ソケットが最も使用されています。

USB Type-A、B、C、マイクロ USB の広範なポートフォリオにより、将来性のある最大 10 Gbit/s の高速デバイス設計が可能です。USB PCB ソケットは、堅牢な規格である USB 2.0、3.0、3.1 に対応しており、高速かつ簡単なデータ転送を実現します。

個々のコネクタは高い耐久性といった要件を満たし、信頼性の高い接続技術を提供します。

- 最大10.000回のプラグサイクル
- THT、THRまたはSMDのはんだ付け工程に対応
- 180° (垂直 / 縦型) または 90° (水平 / 横型) の種別をご利用いただけます
- ボックス (BX) またはロール (テープオンリール、RL) に梱包
- 強化金属による防食性の向上
- 10 Gbit/sのデータ転送に対応したUSB 3.1 ソケットが高速データ転送を実現
- USB Type-C ソケットは対称的な形状のため差し込み時の間違いがありません
- 安定したプラグ アンド プレイ操作 - システムをシャットダウンまたは再起動せずに接続と切断可能

## 一般注文データ

バージョン	データの最小化 - USBジャック, プリント基板用プラグインコネクタ, USB 2.0, タイプ A, 480 Mbps, THRはんだ付け接続, 90°, プラギング回数: ≥ 1500, 極数: 4, PBT, ニッケル下地メッキ, トレイ (手動式アセンブリ)
注文番号	<a href="#">2563710000</a>
種別	USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118572322
数量	100 items
パッケージ	トレイ (手動式アセンブリ)
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-07-30T00:00:00+02:00

## USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	14 mm	奥行き (インチ)	0.5512 inch
高さ	9.74 mm	高さ (インチ)	0.3835 inch
下位バージョンの高さ	6.9 mm	幅	14.5 mm
幅 (インチ)	0.5709 inch	正味重量	2.19 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

極数	4	LED	いいえ
ソルダーピン長 (l)	2.84 mm	PCB の取り付け	THRはんだ付け接続
ピッチ (インチ) (P)	0.079 "	シールド材質	真鍮
シールド	はい	側面終端、特性	はんだフランジ
差し込み力 / 極、最大	35 N	転送速度	480 Mbps
極当たりソルダーピン数	1	接続方式	はんだ接続
製品ファミリー	データの最小化 - USB ジャック	ピッチ (mm) (P)	2.00 mm
保護度合い	IP20	ブラギング回数	≥ 1500
外向きエルボ	90°	シールド面	ニッケルメッキ
シールドタブ	なし	性能カテゴリ	480 Mbps
はんだ付け工程	手動はんだ付け、フローは んだ付け	引張強度 / 極、最大	10.00 N
はんだピン寸法	八角形	はんだピン位置の公差	0.1 mm

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点	500 V AC	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
公称電圧	30 V	定格電流	250 V ACで1.5 A

## 材料データ

絶縁材	PBT	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II
比較追跡指数 (CTI)	≥ 500	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
保管温度、最小	-20 °C	保管温度、最大	60 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

## 梱包

パッケージ	トレイ (手動式アセンブリ)	VPE 長	250.00 mm
VPE幅	199.00 mm	VPEの高さ	19.00 mm

**USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

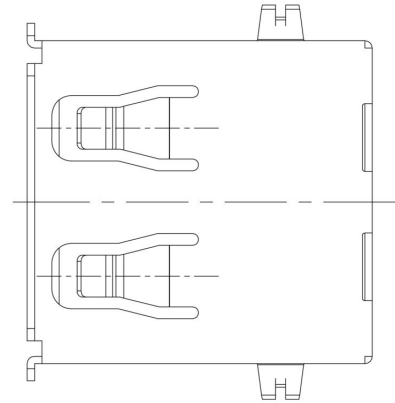
USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

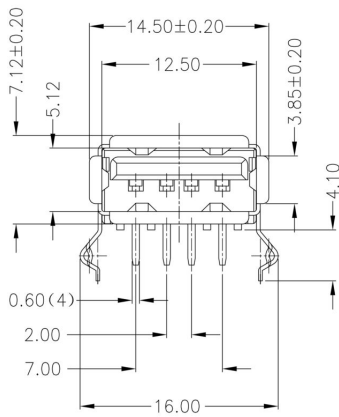
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

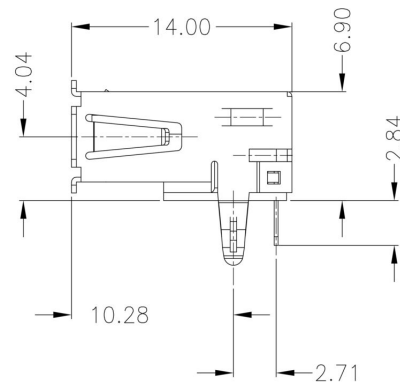
寸法図



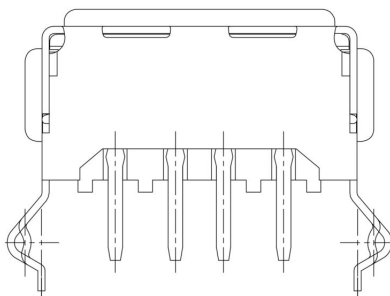
寸法図



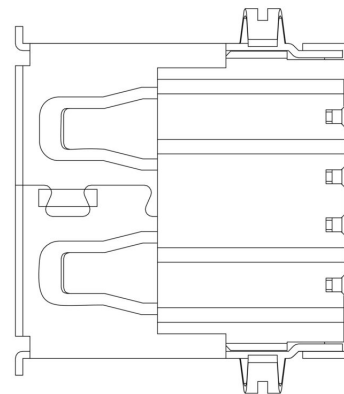
寸法図



寸法図



寸法図



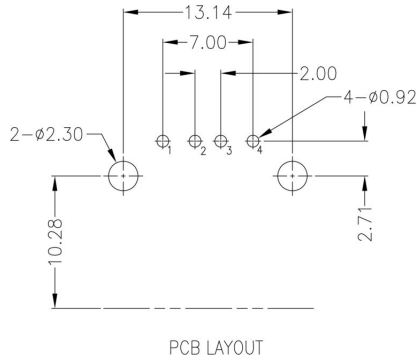
**USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

PCB設計



凡例

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL	
										<b>Colour / Special Option</b>	
										<b>BL</b>	blue (plastic)
										<b>BK</b>	black (plastic)
										<b>WH</b>	white (plastic)
										<b>SO</b>	customized product
										<b>Packaging</b>	
										<b>TY</b>	Tray in box (manual assembly)
										<b>RL</b>	Tape on Reel (automated assembly)
										<b>TU</b>	Tube
										<b>Contact surface thickness</b>	
										<b>4</b>	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										<b>Solder Pin length</b>	
										<b>N</b>	no use
										<b>3.2</b>	3.2 mm
										<b>1.6</b>	1.6 mm
										<b>D</b>	SMD
										<b>Direction</b>	
										<b>H</b>	Horizontal (90°, side entry)
										<b>U</b>	Horizontal, Upright 90°
										<b>V</b>	Vertical (180°, top entry)
										<b>Number of Ports</b>	
										<b>1</b>	1 Port
										<b>21; 41; ...</b>	multi ports about each other, Multilevel
										<b>Assembly on PCB</b>	
										<b>R</b>	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering
										<b>S</b>	Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering
										<b>T</b>	Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
										<b>Type / Performance</b>	
										<b>2.0A</b>	USB 2.0 Type A
										<b>3.0A</b>	USB 3.0 Type A